

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第1区分
 【発行日】平成30年2月22日(2018.2.22)

【公開番号】特開2017-208332(P2017-208332A)
 【公開日】平成29年11月24日(2017.11.24)
 【年通号数】公開・登録公報2017-045
 【出願番号】特願2017-91953(P2017-91953)
 【国際特許分類】

H 0 1 M 6/34 (2006.01)
 A 6 1 B 5/07 (2006.01)
 C 2 3 C 14/06 (2006.01)
 H 0 4 B 1/3816 (2015.01)

【F I】

H 0 1 M 6/34 A
 A 6 1 B 5/07 1 0 0
 C 2 3 C 14/06 N
 C 2 3 C 14/06 G
 H 0 4 B 1/3816

【手続補正書】

【提出日】平成30年1月11日(2018.1.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】通信装置

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

部分電源を含む通信装置であって、
 複数の穴を画定する接着剤の層を支持構造の第1の位置に堆積してあり、
前記支持構造は、前記複数の穴夫々の底部側に隙間なく連なって残留する支持材料であ
り、

前記接着剤の層に接着する第1の材料を該接着剤の層へ堆積してあり、
 前記支持構造の第2の位置に遷移材料の層を堆積してあり、
 前記遷移材料の層に第2の材料を堆積してあり、
 前記第1の材料及び第2の材料は、導電性流体と接触する際に電位差を示すこと
 を特徴とする通信装置。

【請求項2】

前記接着剤の層は金であること
 を特徴とする請求項1に記載の通信装置。

【請求項3】

接着性を高めるために前記接着剤の層の表面を粗面化してあること
 を特徴とする請求項1に記載の通信装置。

【請求項 4】

前記支持構造はシリコンベースの材料であることを特徴とする請求項 1 に記載の通信装置。

【請求項 5】

前記第 1 の材料は電子ビームを用いた蒸着によって堆積してあることを特徴とする請求項 1 に記載の通信装置。

【請求項 6】

前記接着剤の層は 100 ミクロン未満の厚さであり、
前記第 1 の材料は電子ビームを用いた蒸着によって堆積してあることを特徴とする請求項 1 に記載の通信装置。

【請求項 7】

前記遷移材料の層は、
前記支持構造に前記遷移材料の層を堆積してあり、
前記遷移材料の層の堆積を有する前記支持構造を加熱処理してあり、
結果として生じる構造が第 2 の材料を受け入れる準備が整うように、前記遷移材料の層の露出表面をクリーニングしてあることを特徴とする請求項 1 に記載の通信装置。

【請求項 8】

前記露出表面はイオン銃を用いてクリーニングしてあることを特徴とする請求項 7 に記載の通信装置。

【請求項 9】

部分電源を含む通信装置であって、
複数の穴を画定する接着剤の層を支持構造の第 1 の位置に堆積してあり、
前記接着剤の層に接着する第 1 の材料を該接着剤の層へ堆積してあり、
前記支持構造の第 2 の位置に遷移材料の層を堆積してあり、
前記遷移材料の層に第 2 の材料を堆積してあり
前記第 1 の材料及び第 2 の材料は、導電性流体と接触する際に電位差を示し、
前記複数の穴は、前記第 1 の材料が前記接着剤の層に接着する場合に、前記第 1 の材料の端部の夫々が前記複数の穴の何れかと重なる位置に配置されないように、前記接着剤の層の中央の領域に限定して画定されていることを特徴とする通信装置。

【請求項 10】

前記接着剤の層は金であることを特徴とする請求項 9 に記載の通信装置。

【請求項 11】

接着性を高めるために前記接着剤の層の表面を粗面化してあることを特徴とする請求項 9 に記載の通信装置。

【請求項 12】

前記支持構造はシリコンベースの材料であることを特徴とする請求項 9 に記載の通信装置。

【請求項 13】

前記第 1 の材料は電子ビームを用いた蒸着によって堆積してあることを特徴とする請求項 9 に記載の通信装置。

【請求項 14】

前記接着剤の層は 100 ミクロン未満の厚さであり、
前記第 1 の材料は電子ビームを用いた蒸着によって堆積してあることを特徴とする請求項 9 に記載の通信装置。

【請求項 15】

前記遷移材料の層は、遷移金属の層を前記支持構造に堆積し、前記遷移材料の層の堆積を有する前記支持構造を加熱処理し、結果として生じる構造が第 2 の材料を受け入れる準備が整うように、前記遷移材料の層の露出表面をクリーニングしてあることを特徴とする請求項 9 に記載の通信装置。

を特徴とする請求項 9 に記載の通信装置。

【請求項 16】

前記露出表面はイオン銃を用いてクリーニングしてあることを特徴とする請求項 15 に記載の通信装置。

【請求項 17】

部分電源を含む通信装置であって、
複数の穴を画定する接着剤の層を支持構造の第 1 の位置に堆積してあり、
前記接着剤の層に接着する第 1 の材料を該接着剤の層へ堆積してあり、
前記複数の穴は、前記接着剤の層に対する前記第 1 の材料の接着性を高めるように形成されており、

前記支持構造の第 2 の位置に遷移材料の層を堆積してあり、
前記遷移材料の層に第 2 の材料を堆積してあり、
前記第 1 の材料及び第 2 の材料は、導電性流体と接触する際に電位差を示すこと
を特徴とする通信装置。

【請求項 18】

前記接着剤の層は金であることを特徴とする請求項 17 に記載の通信装置。

【請求項 19】

接着性を高めるために前記接着剤の層の表面を粗面化してあることを特徴とする請求項 17 に記載の通信装置。

【請求項 20】

前記支持構造は、シリコンベースの材料であることを特徴とする請求項 17 に記載の通信装置。